



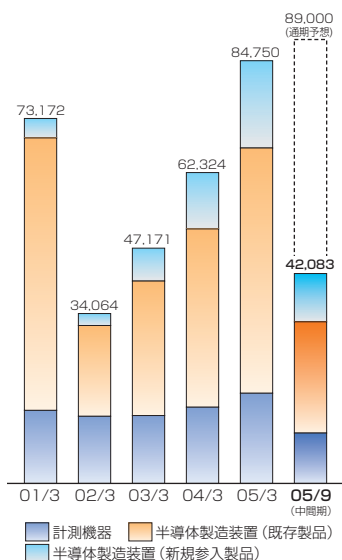
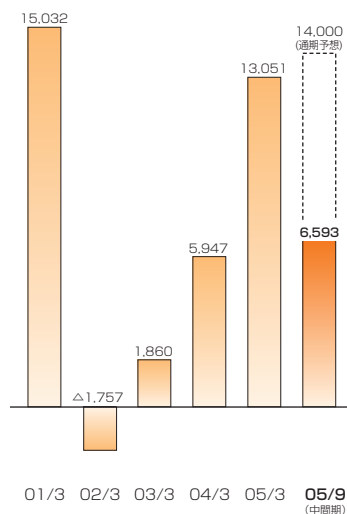
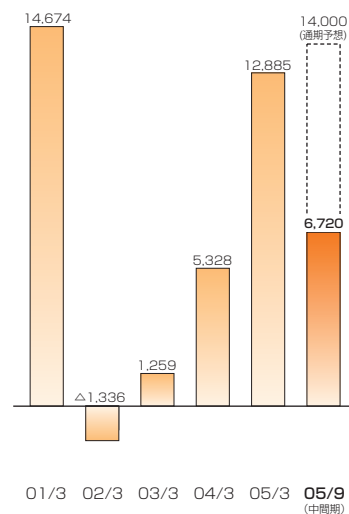
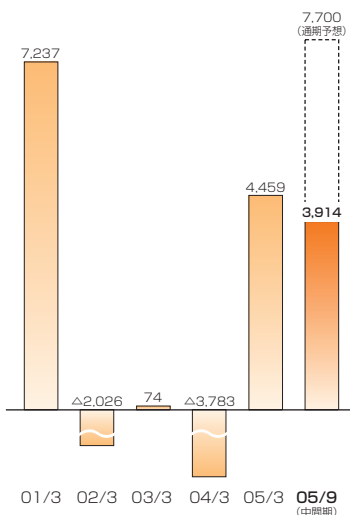
第83期 中間事業報告書

(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

株式会社東京精密

証券コード：7729

財務ハイライト

売上高
(百万円)営業利益
(百万円)経常利益
(百万円)当期純利益
(百万円)

主要財務指標(連結)

経営指標		04/9 (中間期)	05/9 (中間期)
営業利益率	%	18.0	15.7
経常利益率	%	18.3	16.0
当期純利益率	%	9.8	9.3
株主資本当期純利益率(ROE)	%	14.2	11.2
使用総資本当期純利益率(ROA)	%	4.6	3.8
使用総資本回転率	回	0.5	0.4
連結従業員数	人	1,132	1,143
従業員一人当たり売上高	千円	40,628	36,802
従業員一人当たり経常利益	千円	7,433	5,877
従業員一人当たり当期純利益	千円	3,991	3,423
一株当たり当期純利益(EPS)	円	119.07	104.39
株価収益率(PER)	倍	26.0	49.1
当座比率	%	118.9	128.5
流動比率	%	220.5	217.4
固定比率	%	69.5	80.5
固定長期適合率	%	37.6	44.0
負債比率	%	186.3	177.0
自己資本比率	%	34.1	35.2

東京精密 (ACCRETECH) の株式を保有していただき、有難う存じます。厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、株主の皆様が当社株式を保有していただいた目的に沿った経営を目指しております。

経営指標といたしましては、一株当たりの純利益 (EPS) を長期的に増大させていくことを重視しております。これは当社が非常に重要と考えている「WIN-WIN」の関係を株主の皆様と会社との間で創りあげることにつながると確信しております。

当社は、技術指向型の会社です。上記の目的のために当社の経営の大原則である「製品開発の原則」(3頁参照) に沿って技術開発を継続的に行っています。

また当社は、「世界No.1の製品を創る」という目的を共有できる企業および人材と積極的にパートナーシップを結び、ナノテクノロジーレベルの画期的な製品開発を実現しています。協業を成功させるために、「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」というモットーのもと、異文化を包摂したグローバルかつハイブリッドな東京精密 (ACCRETECH) の文化風土を醸成し、世界No.1の製品開発体制の構築に努めております。

2001年1月に導入しましたコーポレートブランド「ACCRETECH」(アクレーテク)は、「共に成長する」という意味の“accrete”と“technology”の合成語です。「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく」という当社の企業理念を表したものです。

株主の皆様にも是非当社の企業理念にご賛同賜り、このコーポレートブランド「ACCRETECH」のもと、さらなる飛躍を目指す当社に、今後とも格別なるご理解とご支援をお願い申し上げます。



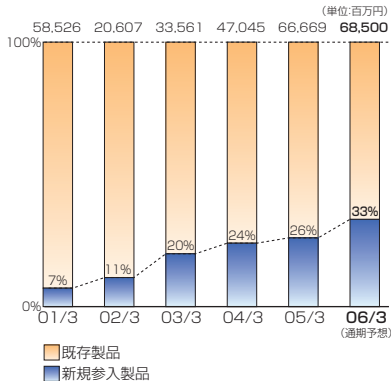
FAQ...よくいただくご質問

2

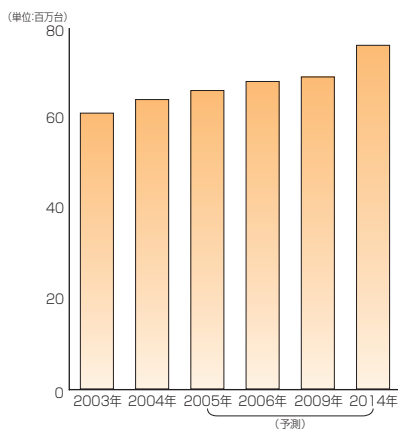
Question-1

2005年度中間期の業績について教えてください。

半導体製造装置
新規参入製品と既存製品の売上比率



世界自動車産業の生産台数予測



出所：世界自動車産業の生産・販売台数予測調査
2005年版 (株)アイアールシー編

2005年度中間期の連結売上高は、420億83百万円（前中間期比7.2%減）、連結営業利益は65億93百万円（同19.2%減）、連結経常利益は67億20百万円（同19.0%減）、連結当期純利益は39億14百万円（同12.1%減）となり、過去最高であった前中間期比では減少ながらも、前年度下期比では大幅な増収・増益となりました。

【半導体製造装置部門】

当中間期の半導体業界は、軽微な調整局面と予想しましたが、パソコン・携帯電話などが好調であった上にデジタル家電も堅調に推移し、半導体メーカーの設備投資も順調に上昇しました。その結果、当中間期の受注高は、341億67百万円（前中間期比11.2%減）、連結売上高は320億5百万円（同12.8%減）となりました。利益面では、固定費削減・内製比率アップによる変動比率引き下げなどのコストダウンを推進した結果、堅調に41億90百万円（同32.3%減）の営業利益を計上しました。

地域別では、前中間期比では国内外とも減少していますが、前年度下期比では韓国・台湾・中国の東アジアおよび国内を中心に回復しています。

製品別では、ウェーハプロービングマシンの300mmウェーハ対応機「UF3000」が前期比大きく伸長し、世界No.1プレーヤーとしてシェアを着実に伸ばし、当期の半導体ビジネスの売上高に大いに貢献しました。また、新規参入製品の1つであるポリッシュ・グラインダも、高成長を実現している製品であり、当中間期の受注・売上ともに好調で、半期ですでに前年度一年分に相当する受注・売上を達成しています。

【計測機器部門】

当中間期も、国内自動車メーカーの設備投資が引き続き活発に推移したこと、市場ニーズに合った製品群により、売上高を伸ばすことができました。当中間期の受注高は107億88百万円（前中間期比27.8%増）、売上高は100億77百万円（同16.5%増）と大きく伸長し、半期ベースの売上高として過去最高を更新しました。生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も24億3百万円（同22.3%増）と増益を達成しました。

地域別に見ますと、国内を中心に前中間期比大きく伸長しています。製品別では、業務提携をしているカールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合させた三次元座標測定機「ザイザックスSVA」シリーズ、カールツァイス社製の新製品であるインライン向け三次元座標測定機「GageMax」、リニアモーター採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム」シリーズ、高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコム」シリーズなど充実した製品ラインアップが売上増に大いに貢献しています。自動車メーカーの部品生産ラインを中心に使用されている自動計測機器も、自動車業界の設備投資が活発であったことを反映し、「パルコム」シリーズを中心に好調でした。「ATC振れ測定システム」も多くの工作機械メーカーに採用されています。

Question-2

2005年度通期の業績の見通しについて教えてください。

世界No.1のシェアを誇る
ウェーハプロービングマシン



「UF3000」

最先端のスキミング技術を搭載した
CNCスキミング三次元座標測定機



「ザイザックスSVA fusion」

製品開発の原則

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1) 好況時の利益の極大化が
はかれる。
(2) 不況時の損失の極小化が
はかれる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、
マーケットが大きくニーズも高
い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、
開発コストをシェアするとともに
開発の成果を共有する。

今下期の連結売上高は469億円を予定しており、2005年度通期の連結売上高は、2年連続の過去最高更新となる890億円（前年度比5.0%増）、連結経常利益は140億円（同8.6%増）、連結当期純利益は過去最高となる77億円（同72.7%増）と予想しています。

【半導体製造装置部門】

近年、製造装置の納期は毎年短くなってきております。特に当社の主力製品であるウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシンは、短納期発注が一般化し、予想を立てにくいこともあり、当社の2005年度下期の半導体製造装置の中で、前述の2製品を主とする既存製品につきましては、慎重に予想しています。しかし、ポリッシュ・グラインダ、ウェーハ外観検査装置、CMP装置などの新規参入製品（2000年度以降に市場参入した製品）につきましては、薄片化・微細化などの技術革新に基づく設備投資が旺盛で、着実な売上伸長が期待でき、通期では2004年度を上回ると予想しています。その結果、半導体製造装置部門の売上高は、下期365億円、通期685億円（前年度比2.7%増）と2年連続で過去最高を更新する見込みです。

【計測機器部門】

計測機器部門の売上高の50%以上を占める自動車関連業界をはじめ工作機械、ベアリングなどの各ユーザーから、活発な設備投資が継続する見通しで、当社の計測機器事業も引き続き、好調に推移すると予想しています。2005年度売上高は下期104億円、通期205億円（前年度比13.4%増）と2年連続で過去最高を更新する見込みです。

Question-3

東京精密の中期計画について教えてください。

当社は中期計画を公表していませんが、引き続き当社の経営の大原則である「製品開発の原則」に従って最先端の製品開発を行い、さらなる業容拡大と高収益なビジネス基盤の構築を目指します。2009年3月は、当社の創業60周年に当たります。ちょうど2008年は北京オリンピックの年でもあり、これまでの経験から2008年度（2009年3月期）の半導体市況は非常に好調になるであろうと予測しています。また、計測機器ビジネスについても、国内自動車メーカーを中心に、2008年度まで積極的に設備投資をしていくことが発表されています。このようなビジネス環境下、当社としては、早期に売上高1,000億円を実現し、2009年3月期には、さらにその業績を上回る過去最高の業績を達成しようという目標をたてています。全体で25%の営業利益率が確保できるよう、コストリダクションに取り組んでいます。2009年3月の創業60周年を最高の業績で迎えられよう、全社一丸となって日々の業務に励んでいます。

「現場計測」と「車体計測」に本格的に進出

東京精密は、お客様のニーズが高まる「現場計測」と「車体計測」に最新のテクノロジーを提案します。

現場計測

従来、自動車業界での精密測定といえば、温度管理された精密測定室における測定が常識でした。生産現場では、ゲージを使用して簡易的な計測のみを行っていたのです。ところが最近では、生産現場におけるゲージの削減、測定結果のデータベース化、測定値の解析結果を工作機械へフィードバックするなどの要望が高まっています。これらの要望にお応えして当社では、CNC表面粗さ形状測定機「サーフコムC5」、高精度CNC三次元座標測定機「CenterMax」および「GageMax」などの製品をラインアップしました。これらの製品は耐環境性に優れ、生産現場における測定の自動化を実現します。さらなるニーズの高まりが予測される生産現場での計測に対して、当社は今後も積極的に取り組んでいきます。

CNC表面粗さ形状測定機
「サーフコムC5」

「生産現場での表面粗さ形状測定を」という要望にお応えした、最新鋭のCNC表面粗さ測定機。5軸制御（駆動部左右、コラム上下、コラム前後、ピックアップ横トレース、ピックアップ回転）により、全自動測定を実現。



車体計測

当社の計測製品の主なお客様は自動車とその関連業界で、計測ビジネスの全売上高の50%以上を占めています。その大半で、エンジン回りなどのパワートレイン系といわれる部品の計測に当社の製品が使われています。従来、パワートレイン系に注力してきた当社ですが、計測ビジネスのさらなる拡大のためにパワートレイン系以外のニーズも取り込んでいます。その第一弾として、自動車のボディーを計測する「車体計測」に本格的に進出しました。非接触ラインセンサー「EagleEye」と組み合わせて、車体を高速で計測する水平アーム型三次元座標測定機「PRO Premium」、車体の金型を高精度で測定するガントリー型三次元座標測定機「MMZ-B」などを用意し、車体計測分野においてビジネスを拡大していきます。

水平アーム型三次元座標測定機
「PRO Premium」

自動車のボディーや、シートメタルなどの車体計測に最適な水平アーム型三次元座標測定機。非接触ラインレーザーセンサー「EagleEye」が搭載可能で、高速計測を実現。



東精エンジニアリングを完全子会社化

2005年10月1日に東京精密は東精エンジニアリングを完全子会社化しました。
グループの付加価値を高め、シナジー効果を創出することで、競争力強化を狙います。



私たちに「測れないモノは造れない」というキーワードをもとに培ってきた高い計測技術と、現場に即応したカスタマイズを含めたサービス体制があります。この強みを活かしてグループに貢献し、幅広くACCURETECH製品の市場浸透に努めています。

株式会社東精エンジニアリング
代表取締役社長

梅中 茂

なぜ子会社化したの？

現在、半導体業界では大口径化や微細化の進展による半導体製造装置の高精度化・高生産性化への強い需要があります。計測機器市場においては、高精度・高品質への高いニーズがあります。このような状況の中で、お客様のニーズに的確に対応し、最先端の技術による世界No.1製品を提供していくためには、東京精密と東精エンジニアリングが一体化し、より一層連携を図り、従来以上に迅速かつ機動的な事業運営を行うことが必要になったのです。

子会社化のメリットは？

東精エンジニアリングは、設立当初から精密加工分野のさまざまな計測機器の提供と、それらの計測機器のサービス業務を行ってきました。同社の完全子会社化により、製品開発や新事業に関する情報が共有でき、役割が明確になります。また、製造部門や間接部門の効率的な有効活用などのシナジー効果が創出され、東京精密グループの企業価値がより一層高まります。

これからの展開は？

東精エンジニアリングの汎用計測サービス部門では、すでに東京精密の汎用計測機器のインライン化に向けた共同活動を開始しています。また、自動計測部門では、売上拡充に向けて海外サービス拠点を増強しています。半導体事業部門では、ウエーハ製造装置の性能・品質を向上させ、高い市場占有率を今後も継続していく取り組みを行っており、グループの競争力の強化を図っています。



◀ 本社

所在地：
〒300-0006 茨城県土浦市東中貫4-6

エッジラインディングマシン

「W-GM-5200」▶

世界市場で90%以上という圧倒的な強さを誇る、世界No.1のエッジラインディングマシン（面取り機）

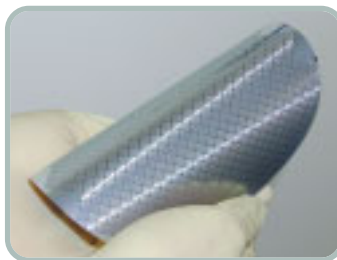


社会を支えるアクレーテクの技術 [半導体製造装置：ポリッシュ・グラインダ]

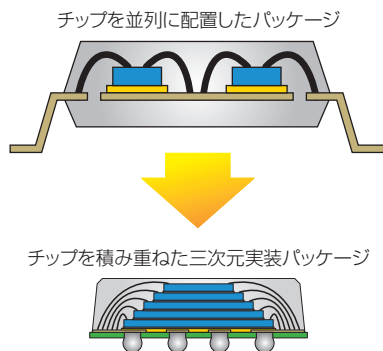
ポリッシュ・グラインダってなんだろう？

ポリッシュ・グラインダは、ウェーハの裏面を研削・研磨することにより、薄くて耐性の強いウェーハをつくる装置です。現在、携帯電話などのモバイル製品の小型軽量化が進み、複数の半導体チップを積み重ねて一つの入れ物（パッケージ）に収める必要性が高まっています。ポリッシュ・グラインダは、このようなニーズを満たすために必要不可欠な業界標準装置として売上を伸ばし、世界No.1のシェアを誇っています。

曲げても割れない薄くて丈夫なウェーハ▶



薄片化って何のこと？



なぜ薄くする必要があるの？

従来、パッケージの中に複数個の半導体チップを搭載する場合は、チップを並列に配置していました。近年、パッケージの数の低減および小型軽量化が求められるようになり、チップを縦方向に積み重ねる三次元実装という新しいパッケージが開発されました。三次元実装により、パッケージの縦横の大きさが小さくなります。さらにチップそのものの厚さを薄くすることで、パッケージの高さも低く抑えることができます。また、パッケージの高機能化の要求が高まり、限られた高さのパッケージに、より多くのチップを収めることが必要になってきました。そのためには、チップの厚みをさらに薄くし、何層にも積み重

ねる必要があります。現在、最先端の三次元実装パッケージでは、わずか70～50ミクロンのチップが5個以上積み重ねられています。

どんなところで使われているの？

三次元実装というパッケージが搭載されている代表的な製品は、携帯電話、デジタル・カメラ、携帯音楽プレーヤー、ICカードなど、人々が持ち歩く製品です。最近では、パソコン、自動車の各種センサーなどにも搭載され、そのニーズはますます広がっています。



ココが凄い！（その1）

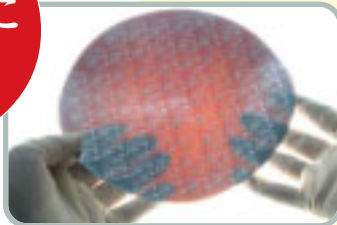
発明したのは東京精密

90年代後半、欧州メーカーから、ICカード向けに厚さ50ミクロンのウェーハをつくりたいという要望がありました。しかし当時のウェーハは、薄いものでも280ミクロン程度でした。ウェーハを薄くするバックグラインダという装置で、ウェーハを薄くすることはできても、その加工だけでは、ウェーハが薄すぎて割れてしまうのです。薄くて丈夫なウェーハに加工するためには、バックグラインダによる加工で生じるダメージ層（微細な研磨痕で、ウェーハが割れる原因となるもの）を取り除く必要があります。当時考えられていた方法は、バックグラインダ加工の後、ウェットエッチャーという装置で、ダメージ層を除去することでした。しかし、2台の装置での加工にはいくつかの問題があり、満足のいく結果は得られない状態でした。

東京精密は、薄いウェーハのニーズは将来的には拡大し、成長性の高い市場になると考え、市場が本格的に立ち上がる前に、お客様の要望に応える新しい装置の開発に着手しました。そして、ウェーハを薄くし、ダメージ層を除去することを一台の装置で行う「ポリッシュ・グラインダ」という世界初の製品を作り上げました。



こんなに
薄い！



将来的にどれ程の薄さが求められるのか、ニーズを確かめながら開発を進める必要がありますが、当社ではパターン付きウェーハで「5ミクロンの薄さ」の加工に成功しました。厚さ5ミクロンのウェーハは、後ろの手が透けて見えるほどの薄さです。

ココが凄い！（その2）

業界標準で、世界No.1シェアの製品に成長

2000年に市場投入後、ポリッシュ・グラインダは毎年着実に売上を伸ばして業界標準の装置となり、薄物ウェーハ加工装置分野における第一人者として、圧倒的なポジションを構築しました。当中間期も、すでに昨年1年分に匹敵する売上高を達成し、高い成長を遂げています。携帯電話の多機能化、映像など記録用メモリデバイスの継続的な成長、電化する自動車向けデバイスの拡大等を考慮すると、薄いウェーハの需要はまだ拡大すると考えています。

当初は2工程を1台の装置で行う「PG」シリーズからスタートしたポリッシュ・グラインダも、お客様からのご要望に応え、今では、4つの工程、5つの工程を1台で行う「PG-RM」「PG-PRM」「PG-DRM」シリーズまで、製品ラインアップも拡充されました。新しい技術課題に挑戦し、ポリッシュ・グラインダは進化を続けます。

中間連結財務諸表

注:中間連結財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

中間連結損益計算書

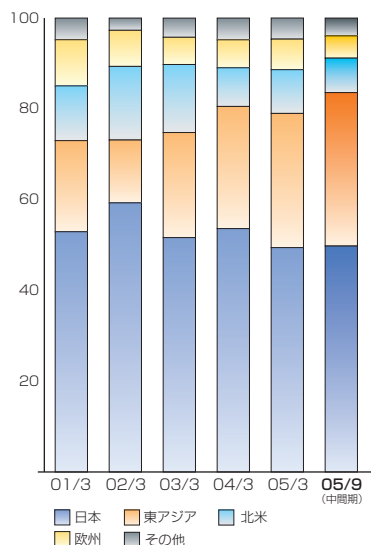
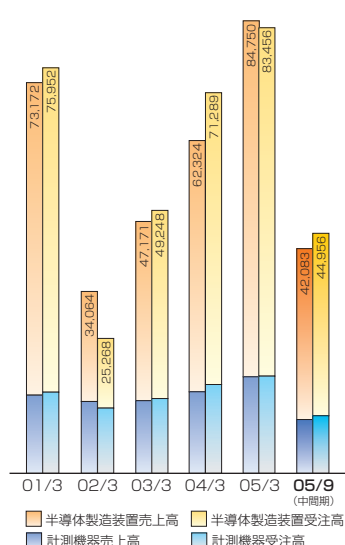
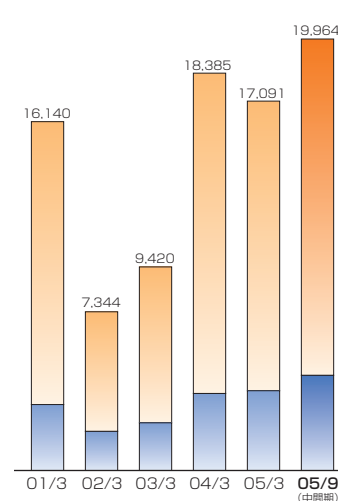
単位:百万円

科目	前中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)	当中間連結会計期間 (05.04.01~05.09.30)
売上高	45,340	42,083
売上原価	30,847	29,207
売上総利益	14,493	12,875
販売費及び一般管理費	6,336	6,282
営業利益	8,157	6,593
営業外収益	323	434
営業外費用	185	308
経常利益	8,295	6,720
特別利益	184	114
特別損失	583	8
税金等調整前中間純利益	7,895	6,827
法人税、住民税及び事業税	1,207	2,543
法人税等調整額	2,001	145
少数株主利益	232	223
中間純利益	4,454	3,914

中間連結剰余金計算書

単位:百万円

科目	前中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)	当中間連結会計期間 (05.04.01~05.09.30)
(資本剰余金の部)		
資本剰余金期首残高	11,806	12,017
資本剰余金増加高	211	—
新株引受権の権利行使 による増加高	211	—
資本剰余金減少高	—	—
資本剰余金中間期末残高	12,017	12,017
(利益剰余金の部)		
利益剰余金期首残高	10,273	13,596
利益剰余金増加高	4,454	3,914
中間純利益	4,454	3,914
利益剰余金減少高	574	572
配当金	560	562
取締役賞与金	14	9
利益剰余金中間期末残高	14,153	16,938

地域別売上高構成比
(%)事業別売上高/受注高
(百万円)事業別受注残高
(百万円)

中間連結貸借対照表

単位:百万円

科目	前連結会計年度末 (05.03.31)	当中間連結会計期間末 (05.09.30)	科目	前連結会計年度末 (05.03.31)	当中間連結会計期間末 (05.09.30)
流動資産	73,752	74,832	流動負債	34,941	34,383
固定資産	27,240	29,603	固定負債	30,538	30,596
有形固定資産	13,885	15,069	負債合計	65,479	64,980
無形固定資産	2,581	2,111	少数株主持分	2,510	2,700
投資その他の資産	10,773	12,423	資本		
繰延資産	0	0	資本金	7,392	7,392
資産合計	100,993	104,436	資本剰余金	12,017	12,017
			利益剰余金	13,596	16,938
			その他有価証券評価差額金	70	436
			為替換算調整勘定	△9	39
			自己株式	△63	△68
			資本合計	33,003	36,755
			負債、少数株主持分及び資本合計	100,993	104,436

貸借対照表

当中間期末における総資産は、前期末と比べて34億43百万円増の1,044億36百万円となりました。流動資産は、売上増加に伴う売上債権の増加を主な理由として、前期末と比べて10億80百万円増の748億32万円となりました。固定資産は、八王子・土浦に建設しました新工場関連の設備投資などによる固定資産の増加を主な理由として23億63百万円増の296億3百万円となりました。負債合計は、流動負債の減少で、前期末と比べて4億99百万円減の649億80百万円となりました。また、2005年9月末の自己資本比率は35.2%となり、前期末比2.5%向上しました。

中間連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円

科目	前中間連結会計期間 (04.04.01~04.09.30)	当中間連結会計期間 (05.04.01~05.09.30)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,554	1,108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△857	△4,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,847	2,365
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	46
現金及び現金同等物の増減額	△2,092	△1,101
現金及び現金同等物の期首残高	12,242	11,838
現金及び現金同等物期末残高	10,149	10,737

キャッシュ・フロー

当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末より11億01百万円減少し、107億37百万円となり、前中間期と比べると5億88百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益(68億円)、減価償却費(13億円)、売上債権の増加(△12億円)、たな卸資産の増加(△11億円)、および仕入債務の増加(11億円)、法人税等の支払(△26億円)などにより11億08百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資支出や長期定期性預金の預入により46億22百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加や配当金の支払などにより23億65百万円の収入となりました。

中間財務諸表(個別)

注:中間財務諸表の数値は百万円以下を切り捨てて表示しています。

10

中間貸借対照表(個別決算)

単位:百万円

科目	前会計年度末 (05.03.31)	当中間会計期間末 (05.09.30)
流動資産	63,152	64,667
固定資産	24,009	27,038
有形固定資産	9,764	11,020
無形固定資産	2,287	1,845
投資その他の資産	11,958	14,173
資産合計	87,161	91,706

科目	前会計年度末 (05.03.31)	当中間会計期間末 (05.09.30)
流動負債	30,684	31,760
固定負債	27,388	27,598
負債合計	58,073	59,359
資本		
資本金	7,392	7,392
資本剰余金	12,017	12,017
利益剰余金	9,674	12,568
其他有価証券評価差額金	67	437
自己株式	△63	△68
資本合計	29,088	32,347
負債及び資本合計	87,161	91,706

中間損益計算書(個別決算)

単位:百万円

科目	前中間会計期間 (04.04.01~04.09.30)	当中間会計期間 (05.04.01~05.09.30)
売上高	39,505	37,558
売上原価	28,910	28,182
売上総利益	10,595	9,375
販売費及び一般管理費	4,319	4,443
営業利益	6,275	4,932
営業外収益	440	536
営業外費用	159	221
経常利益	6,556	5,247
特別利益	184	20
特別損失	583	4
税引前中間純利益	6,156	5,264
法人税、住民税及び事業税	615	1,831
法人税等調整額	1,801	△23
中間純利益	3,739	3,456
前期繰越利益	3,903	3,383
中間未処分益	7,642	6,839

ネットワーク



1 本社(業務会社)



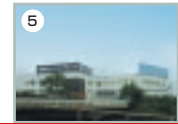
2 八王子工場(半導体社)
株式会社アクレーテックマイクロテクノロジー



3 土浦工場(計測社)

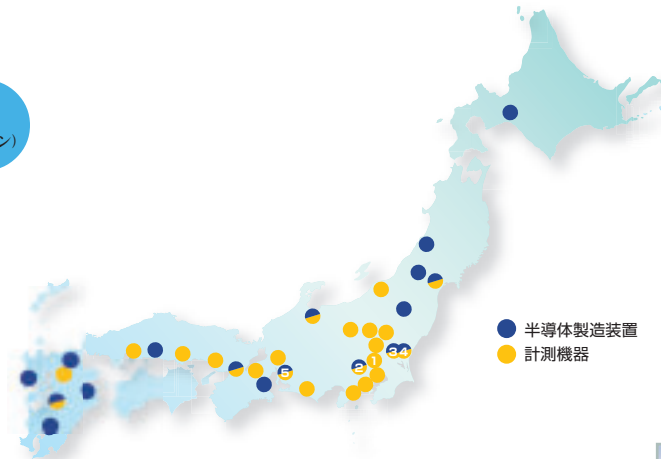


4 伊東精工エンジニアリング
本社・工場



5 伊東精工エンジニアリング
名古屋工場

国内主要拠点 (営業所・サービスステーション)



6 Accretech USA, Inc.



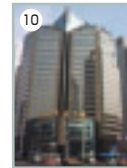
7 Accretech
(Europe) GmbH



8 Accretech
(Malaysia) Sdn. Bhd.

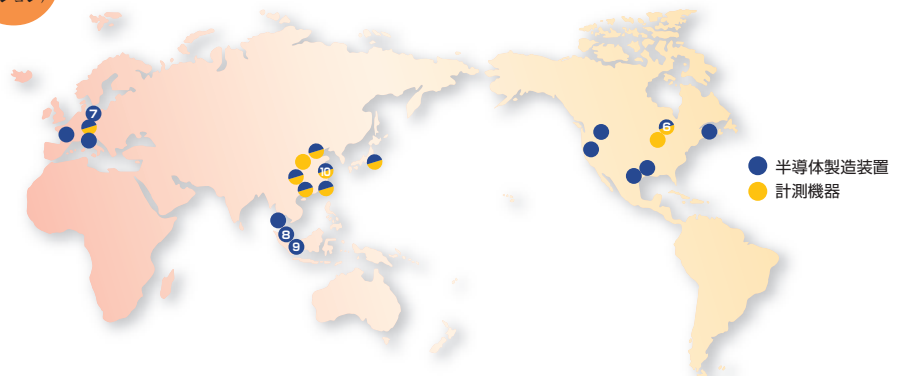


9 Accretech
(Singapore) Pte. Ltd.



10 Accretech
(China) Co., Ltd.

海外主要拠点 (営業所・サービスステーション)



会社概要

(平成17年9月30日現在)

12

商号	株式会社 東京精密 (TOKYO SEIMITSU CO., LTD.)	
設立	昭和24年3月28日	
資本金	7,392,064,755円	
証券取引所	東京証券取引所 市場第一部	
会社が発行する株式の総数	110,501,100株	
発行済株式の総数	37,494,533株	
株主数	18,092名	
役員	代表取締役会長	大坪 英夫
	代表取締役社長 CEO兼COO	鈴木 貞勝
	代表取締役EVP 計測社担当	藤森 一雄
	代表取締役EVP 半導体社担当	長澤 英二
	代表取締役EVP兼CFO 業務会社担当	太田 邦正
	取締役グループCIO	梅中 茂
	取締役	高城 英明
	取締役	ウォルフガング ボナツ
	取締役	グレッグ セバスチャン
	取締役	吉田 均
	取締役	木村 龍一
	監査役(常勤)	吉儀 肇
	監査役	輕部 昭三郎
	監査役	山本 清次
	監査役	久富 眞志
従業員数	638名(単体) 1,143名(連結)	
主要取引銀行	みずほコーポレート銀行	大手町営業部
	三井住友銀行	本店
	みずほ信託銀行	本店
	東京三菱銀行	新宿中央支店
	常陽銀行	土浦支店
	関東つくば銀行	本店
	りそな銀行	吉祥寺支店

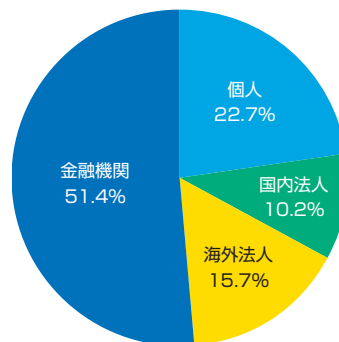
事業所	業務会社	東京都三鷹市
	半導体社	東京都八王子市
	計測社	茨城県土浦市
営業所	東北(宮城県仙台市)	長野(長野県岡谷市)
	○山形(山形県山形市)	浜松(静岡県浜松市)
	茨城(茨城県土浦市)	名古屋(愛知県三好町)
	宇都宮(栃木県宇都宮市)	小牧(愛知県西春町)
	埼玉(埼玉県さいたま市)	京滋(滋賀県守山市)
	東京(東京都三鷹市)	◎大阪(大阪府吹田市)
	○東京(東京都八王子市)	加古川(兵庫県加古川市)
	西東京(東京都八王子市)	岡山(岡山県岡山市)
	川崎(神奈川県川崎市)	広島(広島県広島市)
	新潟(新潟県分水町)	九州(福岡県久留米市)
	厚木(神奈川県厚木市)	○九州(大分県大分市)
	北陸(富山県富山市)	
	(注)◎:全製品取扱 ○:半導体製品取扱 無印:計測製品取扱	

株式の状況

大株主

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	7,846	20.9
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	2,659	7.1
野村信託銀行株式会社(投信口)	2,052	5.5
財団法人精密測定技術振興財団	1,058	2.8
株式会社みずほコーポレート銀行	800	2.1
三井生命保険株式会社	660	1.8
日本精工株式会社	650	1.7

所有者別状況(株式数比率)



株主メモ

決算期 毎年3月31日
定時株主総会 毎年6月中 基準日毎年3月31日
その他必要あるときは、あらかじめ基準日を公告いたします。
名義書換代理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱所 〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
同取次所 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 全国各支店
株式取扱手数料 名義書換 無料
新株券交付 無料
公告掲載新聞 東京都において発行される日本経済新聞
(ただし、決算公告につきましては当社のホームページに掲載しております。)



キリトリ線

郵便はがき

1 8 1 - 8 7 9 0

料金受取人払

三鷹局承認

722

差出有効期限
平成18年3月
31日まで

東京都三鷹市下連雀9-7-1

株式会社 東京精密
業務会社 総務室 宛



モバイルサイトを
開設いたしました。

このたび、株主の皆様をはじめ、幅広いお客様へ情報をご提供するため、いつでもどこでも当社のIR情報やニュースリリースを見ることができるモバイルサイトをオープンいたしました。



さらに下記の最新情報もお手もとの
携帯電話へお届けいたします。
是非ご登録ください。

(ご登録は各メニューの“利用する”からできます。)

東京精密の
“最新ニュース”

東京精密の
“終値情報”

【モバイルサイトのアドレス】

http://m-ir/c/7729

※QRコード対応の携帯電話をお持ちの方は、右のバーコードで簡単にアクセスできます。



TOKYO SEIMITSU
http://www.accretech.jp